

性能参数			
项目	测试条件	ALPHA参数	ALPHA典型测试数据
最大额定工作温度 工作温度范围			70°C -65°C ~ +155°C
热冲击 过载	-65°C/30 min. ↔ +155°C/30 min., 5次循环 额定电压 x 2.5, 5 sec.	±0.1% ±0.1%	±0.03% ±0.03%
低温存储和工作 基板弯曲测试	-65°C, 无负载, 24 hrs. → 额定电压, 45 min. 基板弯曲 3 mm, 60 sec.	±0.1% ±0.1%	±0.05% ±0.05%
绝缘电阻 电特性 焊接特性 耐湿性	大气压下: AC 200V, 1 min. DC 100V, 1 min. 260°C, 10 sec. +65°C ~ -10°C, 90% RH ~ 98% RH, 额定电压, 10次循环 (240 hrs.)	±0.05% 大于 10,000 MΩ ±0.1% ±0.1%	0.01% 大于 10,000 MΩ ±0.03% ±0.03%
冲振动, 高频	100G, 6 ms, 锯齿波, X, Y, Z, 各10次循环 20G, 10 Hz ~ 2,000 Hz ~ 10 Hz, 20 min., X, Y, Z, 各2.5 hrs.	±0.05% ±0.05%	±0.01% ±0.01%
寿命	70°C, 额定功率, 1.5 hr. - ON, 0.5 hr. - OFF, 2,000 hrs	±0.1%	±0.05%
存储寿命	15°C ~ 35°C, 15% RH ~ 75% RH, 无负载, 10,000 hrs.	±0.05%	±0.01%
高温暴露	155°C, 无负载, 2,000 hrs.	±0.1%	±0.05%

编带包装(基于EIA-481-1)																		
编带尺寸 <p>RBD, RBF: 0.2560.05 RBH: 0.3060.05</p> <p>RBD, RBF: 1.260.1 RBH: 1.8060.1</p>										包装盘尺寸 								
系列	A ₀	B ₀	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	D ₀	系列	A	N	B	C	D	W ₁	W ₂	r
RBD	2.85 ±0.1	3.7 ±0.1	8.0 ±0.2	3.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	f 1.5 +0.1-0	RBD	f 178 ±2	f 60 min.	f 13 ±0.5	f 21 ±0.8	2.0 ±0.5	8.4 +2.0-0	14.4 max.	1.0 ±0.5
RBF	3.4 ±0.1	6.7 ±0.1	12.0 ±0.2	5.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	f 1.5 +0.1-0	RBF	f 178 ±2	f 60 min.	f 13 ±0.5	f 21 ±0.8	2.0 ±0.5	12.4 +2.0-0	18.4 max.	1.0 ±0.5
RBH	6.3 ±0.1	7.8 ±0.1	16.0 ±0.2	7.5 ±0.1	1.75 ±0.1	8.0 ±0.1	2.0 ±0.1	4.0 ±0.1	f 1.5 +0.1-0	RBH	f 178 ±2	f 60 min.	f 13 ±0.5	f 21 ±0.8	2.0 ±0.5	17.0 ±0.3	19.4 ±0.1	1.0 ±0.5

编带容量 | RBH: 1,000 pcs/盘 | RBD, RBF: 4,000 pcs/盘 尺寸单位(mm)

使用表面贴装电流检测电阻注意事项																																			
1. 存储 存储条件或环境可能对电阻引脚的可焊性产生影响。不可存储于高温和高湿环境。建议存储于温度低于40°C, 湿度低于70%RH的环境, 避免接触硫磺气体和含氯气体等。																																			
2. 焊接注意事项																																			
① 回流焊接 建议 • 最高温度: 250+0/-5°C • 高温时间: 10 sec. max. • 室温下冷却																																			
② 浸焊 (波峰或静止) 建议 • 焊接温度: 260°C max. • 浸入时间长: 10 sec.																																			
③ 其他 推荐无腐蚀焊剂, 比如松脂。焊接后, 不可立即给模压外壳施加应力。																																			
3. 清洁 使用挥发性清洁剂比如甲醇或者异丙醇。																																			
4. 电路板设计																																			
① 推奨ランド寸法 焊盘尺寸 焊接面积取决于电阻尺寸和焊接方法, 也受贴装设备和基板材料的影响, 如右图。																																			
② 电路设计 推荐电路如下图所示, 以便使电流从一个方向接近, 通过, 离开贴装电阻。如有条件, 可使用更厚的铜箔。																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">系列号</th> <th colspan="5">尺寸单位(mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RBD</td> <td>2.6 ~ 2.8</td> <td>0.8</td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RBF</td> <td>3.4 ~ 3.6</td> <td>1.2</td> <td>4.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RBH</td> <td>3.8 ~ 4.0</td> <td>2.0</td> <td>4.0</td> <td>0.5</td> <td>1.7</td> </tr> </tbody> </table>							系列号	尺寸单位(mm)					A	B	C	D	E	RBD	2.6 ~ 2.8	0.8	2.0			RBF	3.4 ~ 3.6	1.2	4.5			RBH	3.8 ~ 4.0	2.0	4.0	0.5	1.7
系列号	尺寸单位(mm)																																		
	A	B	C	D	E																														
RBD	2.6 ~ 2.8	0.8	2.0																																
RBF	3.4 ~ 3.6	1.2	4.5																																
RBH	3.8 ~ 4.0	2.0	4.0	0.5	1.7																														